

39th
MEIKO REPORT

第39期 株主通信

(2013年4月1日から2014年3月31日)

CONTENTS

トップインタビュー	P01
2014年度の取り組みについて	P03
連結財務データ	P04
グローバルネットワーク	P05
コーポレートデータ	P06
新技術紹介 / ホームページのご案内	裏表紙

証券コード：6787

株式会社 **メイコー**



株主の皆様におかれましては、平素より当社の事業につきまして格別のご支援とご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社第39期(2014年3月期)MEIKO REPORTをお届けするにあたり、当期の事業の状況と今後の経営戦略についてご説明いたします。

代表取締役社長

尾花 浩一 氏

ニーズを的確に捉え、最高の電子回路基板を提供し続けます。

Q 当期の事業環境と業績についてお聞かせください。

A 国内海外ともに市場は回復。目標は下回るも黒字確保。

当期の事業環境は、世界経済では米国経済が緩やかな回復を続けたほか、欧州でも個人消費の緩やかな回復傾向が見られ、危機的状況が落ち着きつつあります。またアジア各国においても、輸出増加と底堅い内需等に支えられ景気の持ち直しが見られました。国内経済では、政府や日銀の主導による経済・金融政策により株価の上昇や個人消費の増加、雇用の改善など、景気の底入れによる回復基調が継続しています。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、世界的に好調な自動車需要と中国における日本車需要の持ち直しを背景に売上げが拡大しました。またエレクトロニクス業界においても、海外スマートフォン関連の生産規模拡大により基板の需要が増加しました。

このような環境のもと当社グループでは事業の選択と集中の方針により、経営資源を好調な車載関連、海外のスマートフォン関連を中心に生産体制の拡充と受注の拡大に重点投入しました。また前期の損失の計上から、役員報酬や管理職給与の減額、生産性向上に

向けた適切な人員コントロール、事業所の統廃合等の保有資産見直しによる業務体制のスリム化といった経営体質の抜本改革に取り組みました。その結果、前半はスマートフォン関連基板を主力とするベトナム工場と中国武漢第二工場、車載用基板を主力製品とする中国広州工場や新規に車載基板の生産を開始した中国武漢第一工場において生産が拡大したことに加え、経営体質改善効果もあって売上・利益とも増加することができました。後半は、秋に発生したベトナム工場の火災や、想定を上回る製品価格の下落、一部顧客か

2013年度 業績実績 (億円)	前期比 (億円)
売上高	792.3 +185.2
営業利益	9.2 +15.2
経常利益	19.3 +23.1
当期純利益	0.2 +15.9

当期決算のポイント

プラス要因 (前期比)	<ul style="list-style-type: none"> ・車載向け基板の堅調な伸長(中国広州・武漢) ・アジア・中華系スマートフォン向け基板の好調な受注(中国武漢・越南)
マイナス要因 (前期比)	<ul style="list-style-type: none"> ・ベトナム工場火災事故の影響 ・第4四半期における、一部スマートフォン顧客の受注減速 ・製品価格の下落

らの受注の急激な落ち込み等により、当初の計画を下回りましたが、通期では前期の赤字から黒字転換を果たすことができました。

 **今後の経営戦略について
お聞かせください。**

 **拡大する成長市場のニーズを
的確に捉え、生産基盤の拡大を図る。**

当社グループの経営戦略は、世界規模で成長を続けている自動車市場や中国を中心に拡大しているスマートフォン関連端末などの市場を確実に捉えてグローバルに事業規模を拡大し、収益力を高めて安定的な成長を実現することを目指しています。


これらの市場では内外の競合各社が、自社の技術力を高めつつ強いコスト競争力を背景に参入してくるため、競争はますます激しくなってくるものと予想されます。これに対し当社グループは、国内外で強固な生産体制を構築し、新技術の開発もおこないながら最高の品質と納期で製品を顧客企業に提供し、事業の安定成長を図っていきます。

例えば、中国2工場やベトナム工場の生産性の改善、研究開発投資・財務体質の強化を目的とした増資をおこないました。この資金を戦略的に活用して安定的な事業拡大を推進します。また販売面でも、特に海外有力携帯端末メーカーの顧客の獲得や、提携している独シュバイツァーエレクトロニック社との連携による欧州自動車関連顧客との取引拡大等、グローバル

に取引を拡大していきます。

また、新たな取り組みとして、当社は福島工場内の遊休地を利用した太陽光発電事業に参入することを発表しました。震災から復興の途上にある福島県双葉郡広野地区において、地域の復興に弾みをつけるだけでなく、企業の社会的責任として再生可能エネルギーの普及推進に努め地域社会へ貢献するという方針により2015年5月の売電開始を目指します。

 **次期の取り組みについて
お聞かせください。**

 **車載、スマートフォン向けを軸に拡大
成長を推し進めつつ、経営体質の強化
を継続する。**

次期の取り組みに向けて当社グループを取り巻く経営環境は、自動車業界の堅調な拡大が予想されることに加え、中国を中心としたスマートフォン関連機器の市場の拡大も見込まれます。こうした市場環境に対し、新規顧客の積極的な開拓と中国武漢工場やベトナム工場の生産規模を拡大させ生産力を高めていくことで、事業機会を確実に捉え、収益の拡大を図ってまいります。さらに経費削減や経営の合理化も進め、経営体質の強化に努めます。

特にベトナムでは、北部に生産能力拡大に向けた第2の製造子会社を2014年7月に設立します。これにより、中国への一極集中から複数拠点への展開を加速させリスク分散も図ります。さらにこれまで以上に近

隣諸国の新興国に向けた供給能力の強化を見込んでいます。

 **株主の皆様へのメッセージを
お願いします。**

 **安定的な配当の維持と
企業価値の向上に注力。**

当社は、株主の皆様に対する利益向上を経営の重要課題の一つとし、利益配分は経営成績等を総合的に勘案し、安定的な配当の維持に努めています。内部留保は、将来にわたる株主の皆様への利益を確保するため、経営基盤をより一層強化、充実するための投資に充当し、今後の事業展開に役立てることを基本方針としています。

当期の剰余金の配当は、連結業績の経営成績や今後の見通しなどを総合的に勘案し、中間配当金同様、期末配当も1株当たり5円とさせていただきました。当社を取り巻く経営環境は変わらず厳しいものの、株主の皆様をはじめすべてのステークホルダーのご支援、ご期待に応えるべく、施策に対して全力で取り組み、企業価値の向上と持続的な成長に努めてまいります。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2014年度の取り組みについて

2014年度は2013年度から続く自動車業界の堅調な拡大に加え、中国アジアを中心としたスマートフォン市場の拡大も見込まれています。その市場ニーズを的確に捉えるための、2014年度の取り組みをご紹介します。

2014年度の市場動向

自動車市場

自動車市場は好調に推移～前年比**4%**増の約**87百万**台
エレクトロニクス化の進行により、基板需要も増加

スマートフォン タブレット市場

スマートフォン～前年比**29%**増の**12.8億**台
タブレット～前年比**20%**増の**2.4億**台

その他市場

産業用、ヘルスケア、エネルギー関連分野が成長

2014年度連結業績見通し

	通期予定(億円)	当期比(億円)
売上高	860.0	+67.7
営業利益	25.0	+15.8
経常利益	15.0	△4.3
当期純利益	7.0	+6.8

用途別見通し (億円)



■ 車載	381	401
■ スマートフォン	149	198
■ デジタル家電	46	45
■ その他基板	162	165
■ 基板以外	54	51

品種別見通し (億円)



■ 両面板	73	73
■ 4層板	299	326
■ 6層板以上	125	134
■ ビルドアップ	214	255
■ その他基板	27	21
■ 基板以外	54	51

事業推進のポイント

車載及びスマートフォン用基板を軸に売上を拡大し、品質及びコスト改善を推進して、増収・増益を目指す

主な施策

販売	1 車載用基板市場における拡販体制の強化
	2 ハイエンドスマートフォン基板の受注拡大
	3 アセアン地域における新規顧客の開拓推進
生産	1 ベトナムにおける生産体制の整備増強
	2 車載用基板市場において生産キャパ、品質でNo1を目指す
技術開発	1 顧客ニーズを先取りした新製品の開発及び市場投入推進 ハイエンドスマートフォン向け：高多層エニレーヤー基板 車載向け：HDI基板、高周波基板

各工場の重点施策

広州工場

世界最高の車載基板工場を目指す
～安定した高信頼性基板の生産

武漢工場

第一工場 車載基板の生産量拡大

第二工場 生産機種のみドル・ハイエンドスマートフォン向けへの絞込み

ベトナム工場

1. ハイエンドのスマートフォン向け基板の拡大
2. アセアン顧客向けビルドアップ基板の拡大
3. 独シュバイツァー社と合併の車載基板生産ラインの立上げ

ベトナムにおける第2の製造子会社

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd. (メイコータンロン) 設立



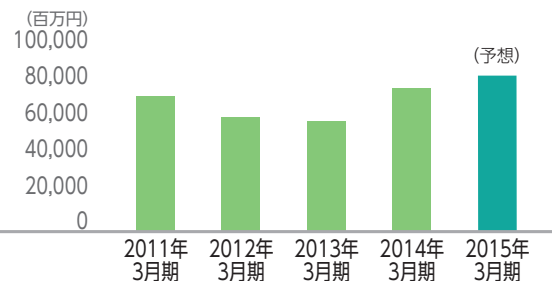
電子回路基板の市場は今後も東南アジア地域での拡大が期待されています。

新たな販売拠点としてMeiko Electronics Thang Long Co., Ltd.(メイコータンロン)を2014年7月に設立します。

新会社設立の目的	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生産拠点の中国一極集中からの分散化 2. ハイエンドHDI基板の生産強化
新会社の特徴	<ol style="list-style-type: none"> 1. パナソニック社の設備を購入し、建屋を借用する～整ったインフラ及び高性能製造装置を活用し、高付加価値商品に対応 2. 需要の増加が期待できるハイエンドの車載向けHDI基板、HDIモジュール基板の生産拠点とする 3. 当面はハイエンドスマホ向け基板の生産を行う

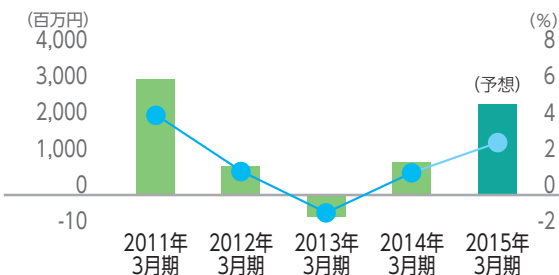
売上高

79,231 百万円



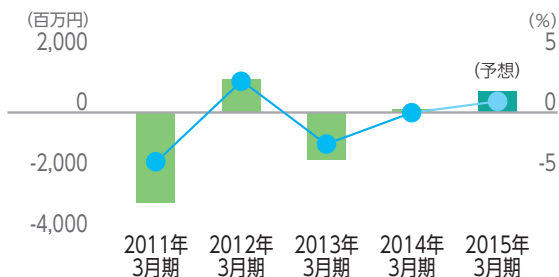
営業利益 / 営業利益率

922 百万円



当期純利益 / 当期純利益率

23 百万円



連結貸借対照表

(単位: 百万円)

	前期末 2013年3月31日現在	当期末 2014年3月31日現在
資産の部		
流動資産	35,101	42,740
固定資産	66,944	72,686
有形固定資産	61,772	67,578
無形固定資産	468	454
投資その他の資産	4,703	4,653
資産合計	102,045	115,426
負債の部		
流動負債	40,177	36,910
固定負債	25,141	33,808
負債合計	65,318	70,719
純資産の部		
株主資本	36,443	41,058
資本金	10,545	12,888
資本剰余金	12,467	14,809
利益剰余金	13,827	13,756
自己株式	△ 396	△ 396
その他の包括利益累計額	282	3,648
その他有価証券評価差額金	△ 115	97
繰延ヘッジ損益	△ 205	△ 81
為替換算調整勘定	603	3,765
退職給付に係る調整累計額	—	△ 133
純資産合計	36,726	44,707
負債純資産合計	102,045	115,426

連結損益計算書

(単位: 百万円)

	前期 2012年4月1日～ 2013年3月31日	当期 2013年4月1日～ 2014年3月31日
売上高	60,709	79,231
売上原価	53,155	69,023
売上総利益	7,553	10,208
販売費及び一般管理費	8,159	9,285
営業利益又は営業損失(△)	△ 605	922
営業外収益	2,628	2,342
営業外費用	2,409	1,333
経常利益又は経常損失(△)	△ 386	1,931
特別利益	1,212	700
特別損失	1,272	384
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△)	△ 446	2,247
法人税等	1,121	2,224
少数株主損益調整前当期純利益又は 少数株主損益調整前当期純損失(△)	△ 1,567	23
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 1,567	23

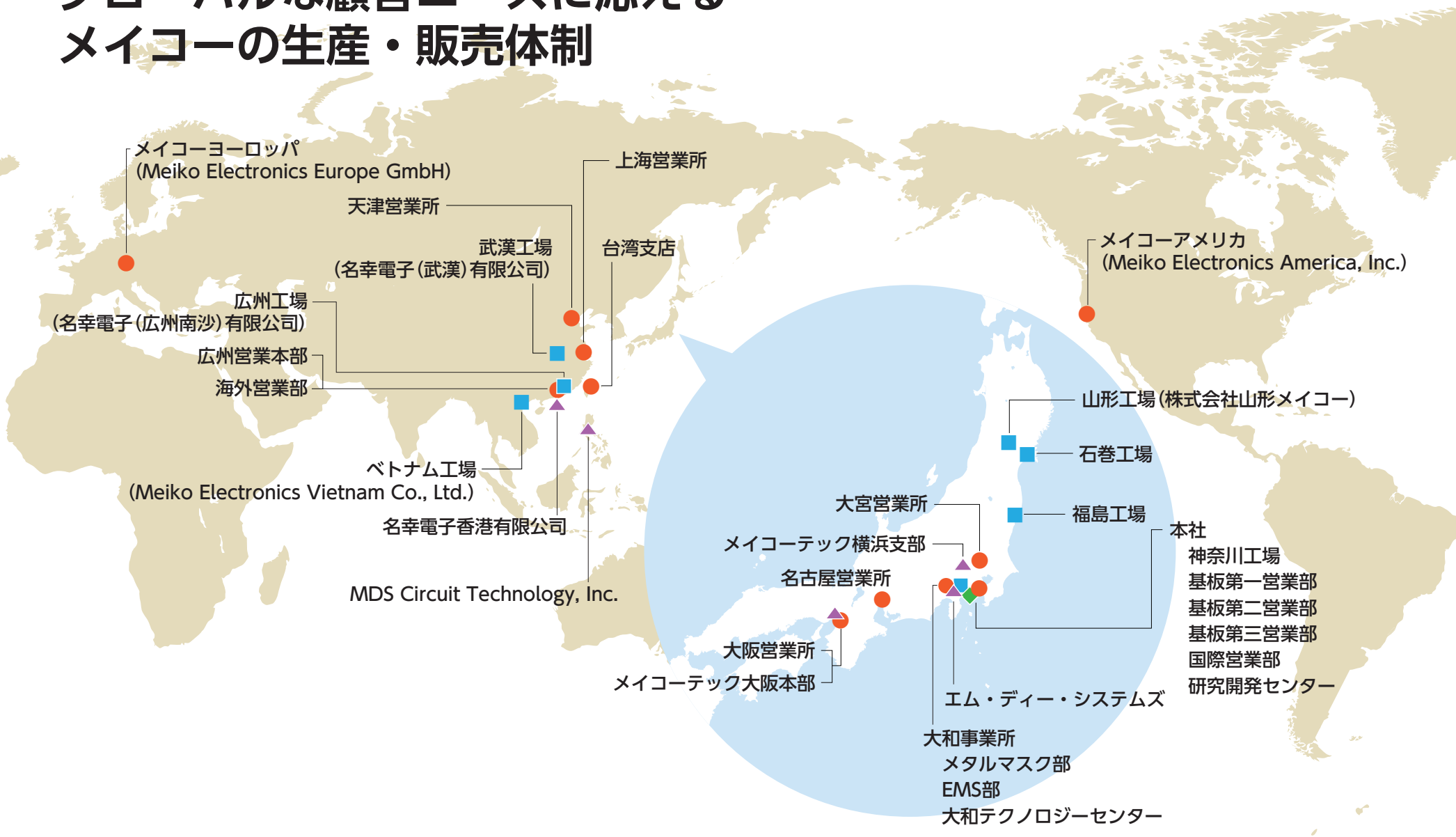
連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

	前期 2012年4月1日～ 2013年3月31日	当期 2013年4月1日～ 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,594	2,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,075	△ 4,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,357	1,186
現金及び現金同等物に係る換算差額	469	378
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	4,346	△ 29
現金及び現金同等物の期首残高	3,751	8,788
非連結子会社との合併に伴う 現金及び現金同等物の増加額	690	—
現金及び現金同等物の期末残高	8,788	8,759

グローバルな顧客ニーズに応える メイコーの生産・販売体制

■ 生産拠点 ◆ 研究開発 ● 販売拠点 ▲ 関連会社



会社概要

商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
本店所在地	神奈川県綾瀬市大上5-14-15
資本金	12,888百万円
従業員数	11,858名(連結) (国内802名)(海外11,056名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造販売およびこれらの付随業務の電子関連事業

役員 (2014年3月31日現在)

代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
取締役専務執行役員	名屋 精一
取締役専務執行役員	平山 隆英
取締役専務執行役員	篠崎 政邦
取締役常務執行役員	鈴木 哲郎
取締役	名屋 晴行
取締役	佐藤 国彦
常勤監査役	伊豫本 齊
監査役	月井 啓之
監査役	越村 安信

関連会社

株式会社山形メイコー	電子回路基板の製造
株式会社エム・ディー・システムズ	電子回路基板の設計
株式会社メイコーテック	電子回路基板の販売
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子回路基板の製造販売
名幸電子(武漢)有限公司	電子回路基板の製造販売
名幸電子香港有限公司	電子回路基板の販売
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子回路基板の製造販売
MDS Circuit Technology, Inc.	電子回路基板の設計
Meiko Electronics America, Inc.	電子回路基板の販売
Meiko Electronics Europe GmbH	電子回路基板の販売

株式情報

発行可能株式総数	63,200,000株
発行済株式の総数	26,174,076株 (自己株式 629,244株を除く)
株主数	6,638名

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,697	17.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,440	5.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,354	5.2
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	675	2.6
PLEASANT VALLEY	631	2.4
名幸興産株式会社	608	2.3
BNYML-NON TREATY ACCOUNT	561	2.1
有限会社ユーホー	521	2.0
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	507	1.9
名屋 晴行	488	1.9

※当社は、自己株式 629,244株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況



株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
公告の方法	電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告が行えない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL: http://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml
上場証券取引所	東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
(インターネットホームページURL)	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会

証券会社の口座をご利用の株主様は、住所変更等のお手続きは、取引証券会社にご照会ください。
証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

ホームページのご案内



TOPページ



CSR報告書



製品紹介(身近なメイコー)

当社ホームページでは最新のIR情報、ニュースリリースの他、製品紹介やCSR情報もご覧いただけます。

当社ホームページもご活用ください。

<http://www.meiko-elec.com/>

新技術 紹介 ①

厚銅基板



厚銅基板は今までのプリント配線板と比べ多くの電流を流すため銅配線が厚いところからネーミングされています。

メイコー研究開発センターでは厚銅基板の開発を進めるにあたり、“環境にやさしい”をキーワードに原料を含む基板製造工程を全て見直し、従来にはない方法で厚銅ながら環境負荷を低減することに取り組んでいます。

メイコー厚銅基板の特長

1 銅を捨てない

プリント配線板の配線は、選択的に銅箔を溶かして作られてきました。我々は不要な部分を溶かすのではなく、必要な部分を作る(アディティブ法)を採用することでこれまで50%程度廃棄されていた銅をゼロにすることで環境負荷を低減しています。

2 銅を均一に速く作る

アディティブ法は銅を厚くするのに多くの時間がかかるだけでなく、配線の配置で厚さのパラツキが大きくなるため厚銅基板を作る方法には適していませんでした。新たに専用装置を開発することで従来の10倍速で配線厚精度±15%以下を実現しています。

3 表面を平らに

厚銅基板の配線板表面は配線の厚さに応じて数100μmの凹凸ができます。お客様の工程において最も重要な接続や絶縁の信頼性を損なう要因となります。我々は配線を配線板の絶縁樹脂内に埋め込む手法(転写法)を多層板形成に応用することで凹凸の少ない平らな配線板をお届けすることができます。

4 細線と厚銅を一つに

今までの厚銅基板は、同一層の配線厚が同じであるため大電流を流す層には信号用の細線を配置することができませんでした。そのため大電流用、制御用で2枚の配線板が用いられてきました。メイコー厚銅基板では、同一層の配線厚を厚いと薄い2水準に対応することで1枚の配線板で大電流と制御の配線設計が可能になります。

大電流を扱う厚銅基板で意外に知られていないのが、電流に対する配線設計仕様や、素子で大量に発生する熱を逃がす手法等があります。メイコーではこれからも様々なお客様のニーズを踏まえ研究開発を進めることで、厚銅基板を通して皆様の希望を形に変えるお手伝いをさせていただきます。

具体的な 使用例について

ハイブリッド車、電気自動車の
インバータ、コンバータに
使われます。

インバータ

交流から直流、
ないしは逆に交換
するモジュールです

電圧を変える
モジュールです

コンバータ